

客户 CUSTOMER: _____

日期 DATE: _____

纳入仕様书

SPECIFICATION

产 品 名 称 PRODUCT NAME: 叠层片式双工器

Multilayer Chip Diplexer

贵 司 料 号 YOUR PART NO.: _____

敝 司 料 号 OUR PART NO.: MDPX18M2455P69-D06B

版 本 号 VERSION.: V2.2

接受 RECEPTION

THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED.

该纳入仕様书已被我司接受

日期:
DATE:公司:
COMPANY:

批准

CFMD

审核

CHKD

接收

RCVD

本纳入仕様书共 7 页

MANUFACTURING NAME

深圳市麦捷微电子科技有限公司

SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD

TEL: 86-755-28085000

FAX: 86-755-28085605

CFMD.

批准

梁启新

CHKD.

审核

付迎华

DSGD.

担当

曾艳峰

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

1

纳入仕様书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

NO.	DATE	CONTENT	APPROVED
1.0	2020.06.01	初稿 Constitute	梁启新
2.0	2020.06.05	更新脚位名称 Update Pin Name	梁启新
2.1	2020.07.09	增加电性曲线 Add Characteristic Curve	付迎华
2.2	2020.08.25	更新电性曲线 Add Characteristic Curve	付迎华

目录 CATALOG

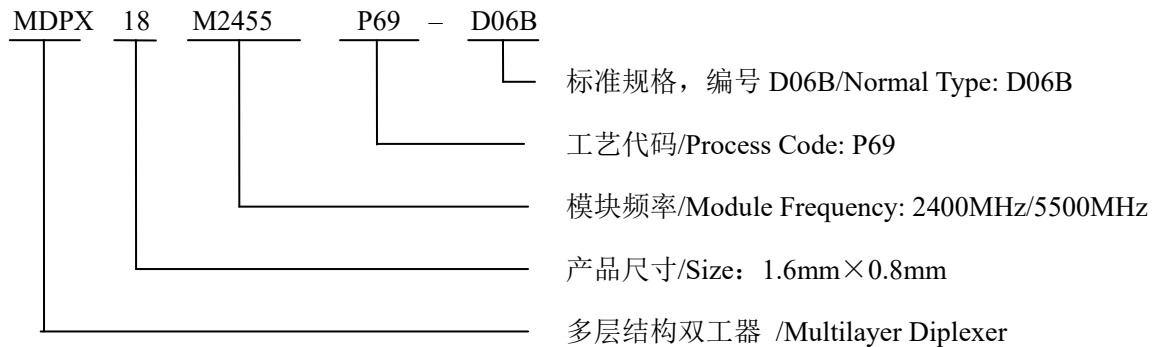
1 适用范围 Scope.....	4
2 品名构成 Product Identification.....	4
3 形状和尺寸 Appearance and Dimensions.....	4
4 测试条件 Testing Conditions.....	5
5 电气性能 Electrical Characteristics.....	5
6 特性曲线 Characteristic Curve.....	6
7 焊接条件 Recommended Soldering Conditions.....	7

1 适用范围 Scope

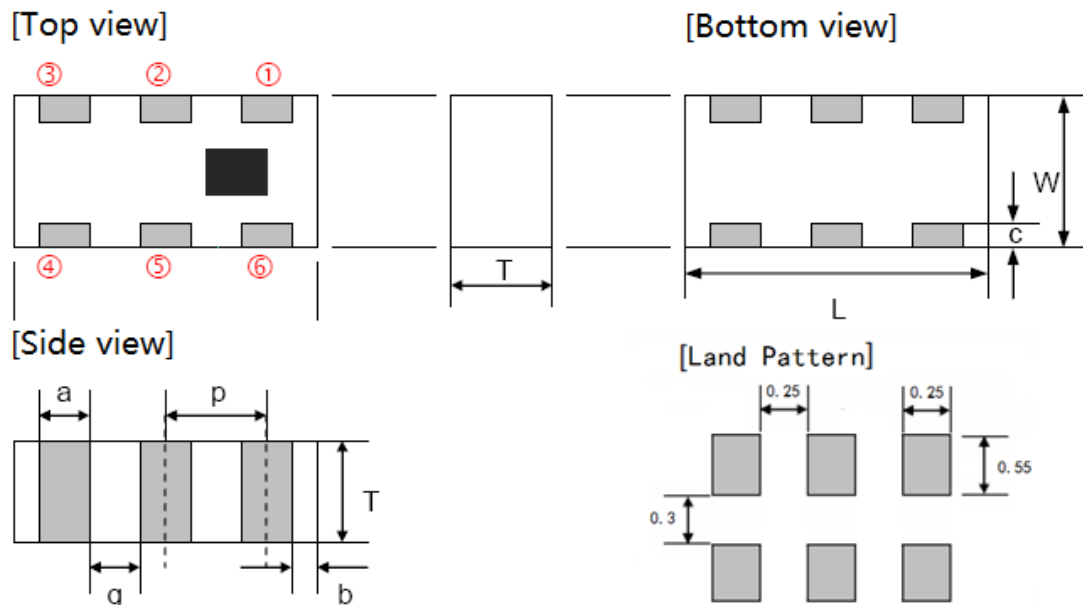
“麦捷”叠层片式双工器系列产品设计用于 5G、LTE、WIFI、Bluetooth、PDA 和无绳电话机中，具有低的插入损耗、高的衰减和小体积 SMD 片式设计，能减少复杂的调校工作，可以简化电路设计。

“Microgate” Multilayer Chip Diplexer series are designed to be used in 5G、LTE、WIFI、Bluetooth、PDA & Cordless phones with low insertion loss and high attenuation as well as small size SMD chip design, which can simplify your complex tuning and circuit design.

2 品名构成 Product Identification



3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material



PIN Configuration

①	②	③	④	⑤	⑥
Higher Freq. Port	GND	Lower Freq. Port	GND	Common Port	GND

Dimension

Unit: mm

L	W	T	a	b	c	g	p
1.6±0.1	0.8±0.1	0.6±0.1	0.2±0.1	0.2+0.1 /-0.15	0.15±0.1	0.3±0.1	0.5±0.05

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

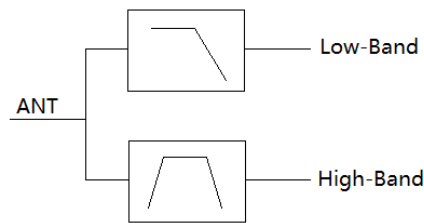
地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

Circuit Diagram



4 测试条件 Testing Conditions

除非另有规定，否则在以下条件下测试 <Unless otherwise specified>

温度 Temperature : Ordinary Temperature (-40 to 85℃)

湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH)

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

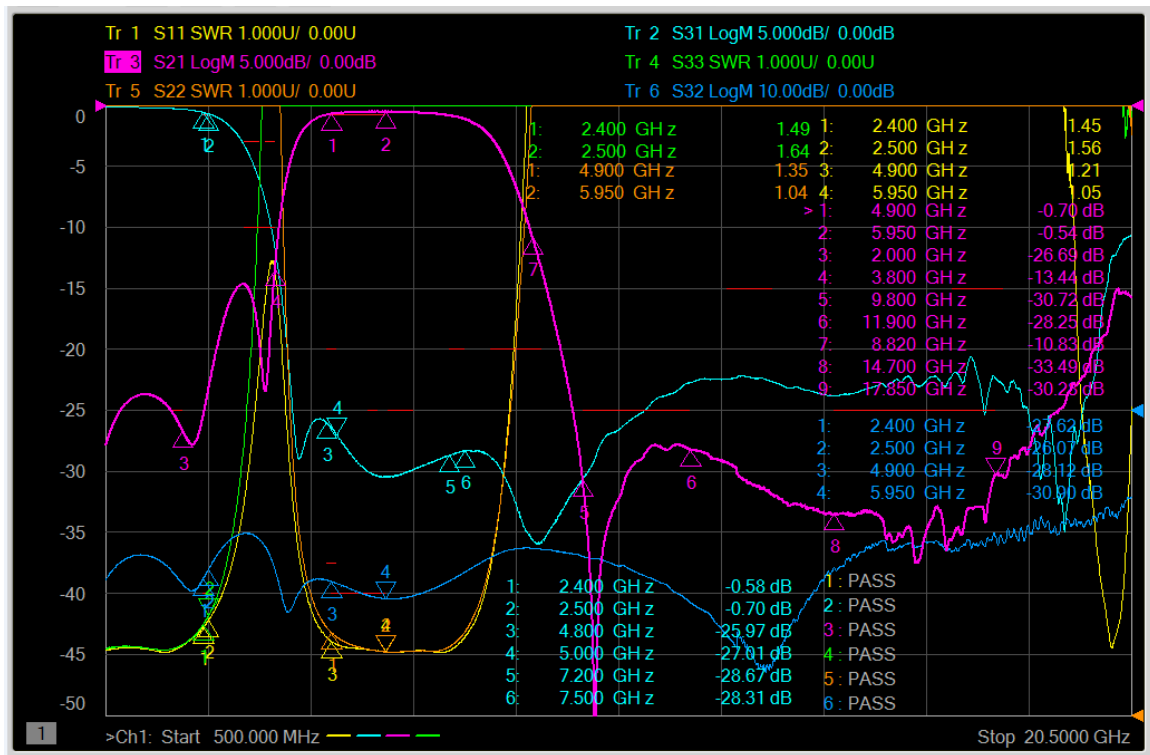
5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85℃

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85℃

No.	Item (项目)	Specifications (特性)
5.1	Frequency Range 频率范围 f1	2400~2500 MHz
	Frequency Range 频率范围 f2	4900~5950 MHz
5.2	Insertion Loss (in f1) 插入损耗(dB)	0.8 max.
5.3	Insertion Loss (in f2) 插入损耗(dB)	0.8 max.
5.4	V.S.W.R (in BW) 驻波比 (in f1 & f2)	2.0 max.
5.5	Attenuation 阻带衰耗 (in f1) (dB)	3 min.@3.2~3.5 GHz 3 min.@3.6~3.8 GHz 20 min.@4.8~5.0 GHz 25min.@5.6~5.8 GHz 25min.@6.0~6.5GHz 20 min. @7.2~7.5GHz 20 min. @8.0~9.0GHz
5.6	Attenuation 阻带衰耗 (in f2) (dB)	25 min. @1.8~2.0GHz 10min. @3.2~3.8GHz 25 min. @9.8~11.9GHz 15 min @12.6~13.5GHz 25min.@14.7~17.85GH 15 min.@17~18GHz
5.7	In/Output Impedance 输入/输出阻抗	50 Ω
5.8	Power Capacity 功率容量	2W max.

6 特性曲线 Characteristic Curve



深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518118

7 焊接条件 Recommended Soldering Conditions

1、焊剂 Flux, Solder

① 使用松香助焊剂，禁止使用卤化物含量超过 0.2wt% 的强酸性助焊剂。

Use rosin-based flux. Don't use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value).

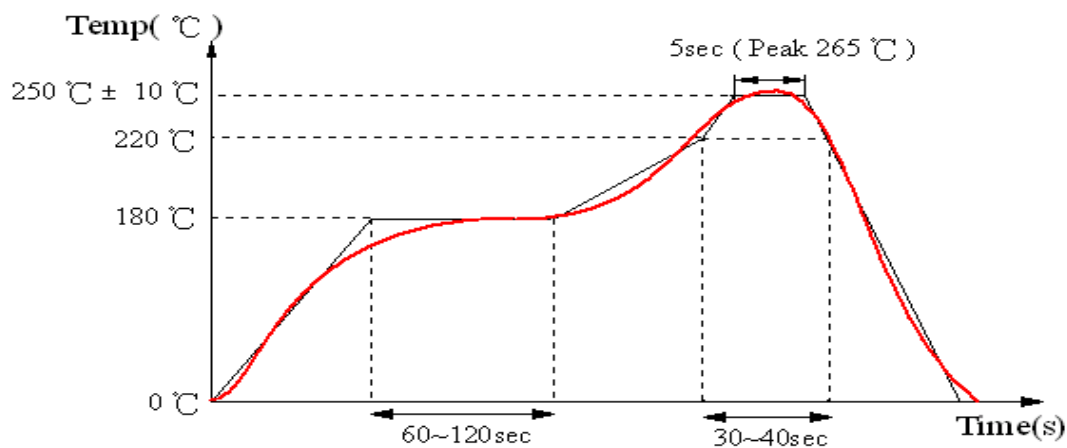
② 使用纯锡焊料 Use Sn solder.

2、回流焊条件 Reflow soldering conditions

● 预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃，焊接完后冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹，导致产品品质下降。

Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality.

● 标准回流焊曲线 Standard soldering profile.



3、手工返工 Reworking with soldering iron

当使用电烙铁进行手工焊接时，以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron.

预热 Pre-heating	150℃, 1 minute
尖端温度 Tip temperature	350℃ max
输出功率 Soldering iron output	80w max
电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron	φ3mm max
焊接时间 Soldering time	3 seconds max